
未來計劃及[編纂]

未來計劃

有關本公司未來計劃的詳細描述，請參閱「業務－增長策略」。

[編纂]

經扣除本公司就[編纂]應付的[編纂]、費用及估計開支後，我們估計[編纂]約為[編纂]港元（基於最高[編纂]每股H股[編纂]港元，假設[編纂]未獲行使）。

根據我們的增長策略，我們擬將[編纂]用作以下用途，並將因應業務需求的演變及市場狀況的變化而作出調整：

- (i) 約[編纂]%（或[編纂]港元）將用於提升我們的研發能力及擴大產品組合。我們相信該等投資將強化我們的集成技術平台，使我們能夠把握AI賦能連接及運算於端側、邊緣端及雲端的增長機遇。我們擬將[編纂]用於撥付研發人員成本、支付外包流片費用，以及採購研發設備、IP授權、EDA工具及其他研發軟件。具體而言，我們將重點聚焦於以下關鍵技術領域：
 - 約[編纂]%（或[編纂]港元）將用於下一代蜂窩通信、AI計算及先進製程芯片設計技術的研發，以應用於終端AI應用。我們計劃開發5G-Advanced及未來6G通信能力，涵蓋算法設計、PHY層及上層協議開發、集成及系統驗證。我們亦計劃開發關鍵AI計算及多媒體知識產權(IP)模組，例如NPU、ISP、DPU及VPU，用於智能手機及其他智能端側設備，並推進4納米及以下製程的芯片設計能力。該等技術將支撐我們新一代智能SoC，使我們能擴大我們的產品組合，以滿足對端側人工智能日益增長的需求；
 - 約[編纂]%（或[編纂]港元）將用於先進SoC集成及低功耗技術的研發。我們計劃開發6納米及以下製程的射頻－基帶單芯片架構，將蜂窩及非蜂窩連接技術以及MCU、NPU、Sensor Hub及ISP集成於單一芯片，並提供配套的turnkey解決方案，包括樣本設計及軟件開發套件，以加速客戶採用。該等技術將支持我們新一代超低功耗的智能可穿戴SoC，推動高性價比可穿戴SoC向聚焦優質用戶體驗的更高性能解決方案演進，進一步鞏固我們於穿戴式設備市場的競爭優勢；
 - 約[編纂]%（或[編纂]港元）將用於先進非蜂窩連接技術的研發。例如，我們計劃開發符合Wi-Fi 8及其他下一代非蜂窩連接標準的基礎IP模組，涵蓋算法設計、PHY層、MAC及上層協議開發、集成及系統驗證，支持Station及AP模式以及與藍牙、GNSS及蜂窩技術的共存能力。該等技術旨在滿足智能手機、智能家居設備、消費電子產品、工業物聯網及其他聯網設備日益增長的多元化連接需求，並支持我們未來向路由器產品的擴展；及

未來計劃及[編纂]

- 約[編纂]%（或[編纂]港元）將用於先進芯片定制技術的研發。我們計劃開發用於高速接口、存儲控制器、SoC架構及先進製程基礎IP，並建立一個配備可復用自主IP組合的多元化研發平台。該等能力將支持端側／云側AI芯片項目的交付，並提升我們ASIC定制解決方案的研發效率及市場競爭力。
- (ii) 約[編纂]%（或[編纂]港元）將用於推動長期增長策略的戰略投資或收購。我們可能選擇性尋求投資及收購機會，該等機會與我們的業務展現協同效應或互補性，包括半導體價值鏈的上下游公司，旨在強化我們的集成技術平台並加速我們於端側、邊緣及雲端的擴展。我們將根據其戰略匹配度、互補技術或產品、商業化前景、整合可行性及財務紀律，以及其管理及研發團隊的專業能力及穩定性，評估潛在機會。截至最後實際可行日期，我們尚未識別任何具體投資或收購目標，亦未就任何該等目標進行磋商。
- (iii) 約[編纂]%（或[編纂]港元）將用於拓展銷售網絡，並提升我們的銷售及營銷能力。我們計劃深化與領先模組製造商、設備製造商、電信運營商、互聯網公司、AI公司及系統供應商的合作，以確保產品貼合市場需求並擴大客戶基礎。我們將招聘更多營銷、銷售及現場應用工程人員以拓展我們的業務開發團隊並提升我們的客戶服務與技術支持能力。我們亦計劃參與行業展覽、博覽會及論壇，與現有及潛在客戶進行互動。
- (iv) 約[編纂]%（或[編纂]港元）將用作營運資金及其他一般企業用途。

倘[編纂]獲悉數行使，我們將額外獲得的[編纂]為[編纂]港元（基於[編纂]為每股H股[編纂]港元），我們擬按比例將該等額外[編纂]用於上述用途。

倘[編纂][編纂]（包括行使[編纂][編纂]）高於或低於預期，我們將按比例調整上述用途的[編纂]分配。

倘[編纂][編纂]未即時用於上述用途，或我們未能按計劃實施任何部分的未來發展計劃，我們可能將該等資金存放於持牌商業銀行及／或其他獲授權金融機構（定義見證券及期貨條例或其他司法管轄區適用法律法規）的短期計息賬戶。於該等情況下，我們將遵守上市規則項下的適用披露規定。倘上述建議[編纂]用途出現任何重大變動，我們將刊發適當公告。